



第 24 回電子デバイス実装研究委員会 公開シンポジウム

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。下記のとおり、第 24 回電子デバイス実装研究委員会を公開シンポジウムとして開催いたします。

電子デバイス実装研究委員会では、ますます小型化・複雑化する電子・精密機器の製造において不可欠なソルダリング、マイクロ/ナノ接合、表面処理、切削加工、放熱設計、微小領域の信頼性評価・分析方法など先進的なテクノロジーについての学術的な議論をおこなっております。今回は近年注目度が高まっている最新のサーマルマネジメントに関する技術を中心に、パワーデバイス関連の実装技術に関するトピックスを集めております。公開シンポジウムにすることで、より広範の研究者・技術者の方と情報交換することができ、本分野のさらなる発展が期待できます。皆様のご参加をお待ち申し上げます。

主催 (一社) スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会
共催 : (一社) エレクトロニクス実装学会 (依頼中)

開催日時 : 平成 30 年 11 月 28 日 (水) 10:30~16:20

開催場所 : 日本橋ライフサイエンスビルディング 201 大会議室
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目 3 番 11 号

定員 : 先着 100 名 [申込み締切り : 平成 30 年 11 月 19 日 (月)]

参加費 : 電子デバイス実装研究委員会 会員 無料 (通常の研究委員会と同様)

有機無機接合研究委員会 会員 5,000 円

上記以外 10,000 円 (すべて資料代含む)

申込方法 : 以下のエレクトロニクス生産科学部会ホームページの申込みフォームよりお申込み下さい。

<http://sps-mste.jp/committee/>

※お支払いは、受付完了メールに記載された振込先まで銀行振り込みにてお願いいたします。

※電子デバイス実装研究委員会会員の方は上記申込フォームからのお申し込みは不要です。

別途ご案内をお送りいたしますので、通常の手続きにてお申込みください。

プログラム

10:30~11:50	『AI チップ等の積層型チップの放熱特性に関する検討』 (40 分)	松本 圭司 (日本アイ・ビー・エム(株))
	『将来型 EV 用途・次世代パワー半導体及び高密度モジュール技術』 (40 分)	谷本 智 ((株)日産アーク)
11:50~13:00	休憩	
13:00~14:10	『低線膨張銅めっきのメリット』 (40 分)	近藤 和夫 ((株)微小めっき研究所)
	『Au 粒子接合の応用展開』 (40 分)	小柏 俊典 (田中貴金属工業(株))
14:10~14:20	休憩	
14:20~16:20	『三菱電機におけるパワーモジュールのパッケージング技術 - 高放熱化技術を中心に -』 (40 分)	西村 隆 (三菱電機(株))
	『パワーモジュール用アルミ一体型基板の開発』 (40 分)	小山内英世 (DOWA パワーデバイス(株))
	『パワエレ - 基板の熱抵抗を活用した実験のような熱解析 - ECU 放熱設計及びその手法 -』 (40 分)	篠田 卓也 ((株)デンソー)